

平成30年8月1日

林野庁近畿中国森林管理局
(公社)日本木材加工技術協会関西支部
早生植林材研究会
京都大学大学院農学研究科森林科学専攻
京都府立大学生命環境学部森林科学科
(一社)平 林 会

産学官共催セミナー ～ 国産早生樹 センダンの使い道 ～

従来の造林樹種よりも短期間で収穫でき、材質も良いなど、新たな造林樹種として大きな可能性を秘める 早生樹センダン。

早生植林材研究会では、兵庫県宍粟市を中心に荒廃農地へのセンダン植栽試験を実施しています。また、近畿中国森林管理局では、センダンを様々な条件の下で試験植栽し植栽適地などを検証しています。

その一方で、センダン植林の普及には、低質材から高品質材まで、多様な用途開発も必要です。早生植林材研究会では、一昨年、熊本県で伐採されたセンダンを利用して様々な活用方法を検討するプロジェクトを実施しました。

本セミナーでは、このプロジェクトの結果を報告し、木質ボードや合板などセンダンの新たな活用方法について議論します。

記

1. 開催日時 平成30年9月14日(金) 13時30分～16時45分
(17時00分～情報交換会)
2. 会 場 大阪港木材倉庫株式会社 2階 会議室
大阪市住之江区平林南1丁目1-52
OsakaMetro南港ポートタウン線(ニュートラム)平林駅①番出口から北へ徒歩8分
3. 定 員 70名(一般公募、要事前申込み)
4. 参加費 無料(情報交換会を除く)
5. 主 催 林野庁近畿中国森林管理局、(公社)日本木材加工技術協会関西支部早生植林材研究会
京都府立大学生命環境学部森林科学科、京都大学大学院農学研究科森林科学専攻
(一社)平林会
6. 詳 細 プログラムや申込み方法など詳細は、別紙資料をご覧ください。



【問い合わせ先】

林野庁近畿中国森林管理局
森林整備部 技術普及課 櫻井、藤田
代 表 : 06-6881-3500(内線3457)
ダイヤルイン : 050-3160-6729

参加無料
要事前申込み(定員70名)
詳細は裏面をご覧ください

産学官 共催セミナー

～国産早生樹 センダンの使い道～

日時 9月14日(金) 13:30～16:45
(17:00～ 情報交換会)

会場 大阪港木材倉庫株式会社 2階 会議室

OsakaMetro 南港ポートタウン線(ニュートラム) 平林駅①番出口から北へ徒歩8分

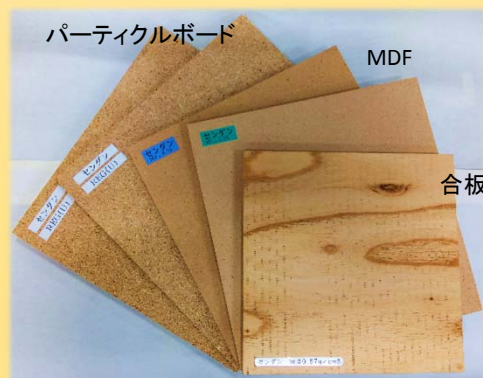
従来の造林樹種よりも短期間で収穫でき、材質も良いなど、新たな造林樹種として大きな可能性を秘める 早生樹センダン。早生植林材研究会や近畿中国森林管理局では、センダンの試験植栽を実施しています。

一方で、センダン植林の普及には、低質材から高品質材まで、多様な用途開発も必要です。

本セミナーでは、早生植林材研究会が一昨年実施したセンダン活用プロジェクトの結果を報告し、木質ボードや合板などセンダンの新たな活用方法について議論します。



解繊前チップとMDF用ファイバー



主催

林野庁近畿中国森林管理局、(公社)日本木材加工技術協会関西支部早生植林材研究会
京都府立大学生命環境学部森林科学科、京都大学大学院農学研究科森林科学専攻、(一社)平林会

後援

(順不同・予定)

(一社)京都府木材組合連合会、(一社)大阪府木材連合会、兵庫県木材業協同組合連合会、和歌山県木材協同組合連合会
奈良県木材協同組合連合会、滋賀県木材協会、京都府森林組合連合会、大阪府森林組合、兵庫県森林組合連合会
(一社)日本木材学会、(一社)日本森林学会、(公社)日本木材加工技術協会九州支部

問い合わせ先

(公社)日本木材加工技術協会関西支部事務局

(日本ノボパン工業株式会社内) TEL 072-221-2122 / FAX 072-221-4430

プログラム

| | | | |
|-------|-------------------------|--|----------------------|
| 13:30 | 開会挨拶 | 近畿中国森林管理局長 | 高野浩文 |
| 13:40 | 近畿中国森林管理局における早生樹造林の取り組み | 近畿中国森林管理局 | 櫻井知 |
| 14:10 | センダンパーティクルボード※1の評価 | 日本ノボパン工業株式会社 永大産業株式会社 | 服部和生 西垣隆幸 |
| 14:30 | センダンMDF※1の評価 | 永大産業株式会社 ホクシン株式会社 | 西垣隆幸 西川嘉文 |
| 14:50 | センダンの乾燥技術 | 奈良県森林技術センター | 成瀬達哉 |
| 15:10 | 休憩 | | |
| 15:30 | 合板・LVL※2の開発 | 兵庫県立森林林業技術センター 永大産業株式会社 (株)ユニウッドコーポレーション | 山田範彦 西垣隆幸 横尾国治 |
| 15:50 | センダン材利用の新たな可能性 | 京都大学農学研究科 大建工業株式会社 | 村田功二 大島克仁 |
| 16:20 | 総合討論 | | |
| 16:40 | 閉会挨拶 | 京都府立大学副学長 | 宮藤久士 |
| 17:00 | 情報交換会 | | |

※1 どちらも木質チップを原料とした板状の製品である木質ボードの一種。

※2 木材を薄く剥いた単板を3枚以上、繊維方向が平行になるよう積層接着した製品。

参加申込方法

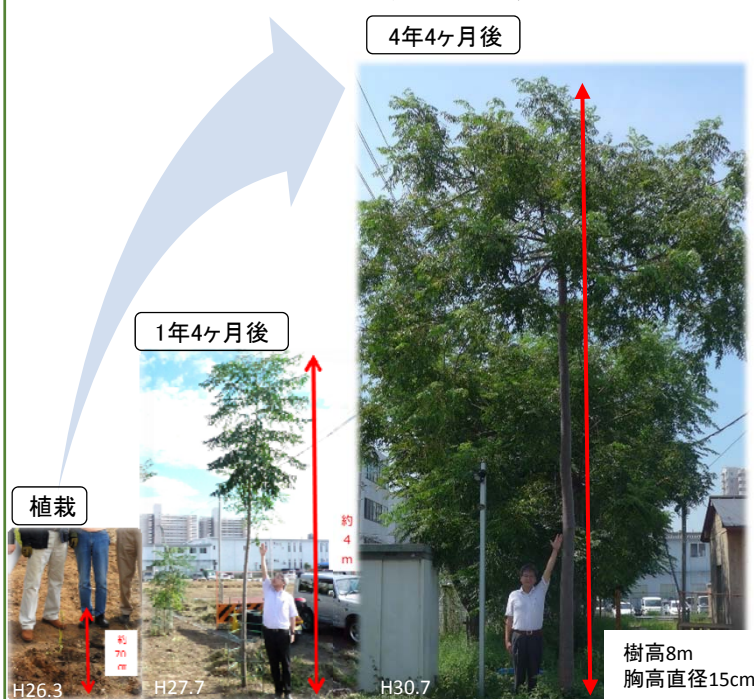
(公社)日本木材加工技術協会関西支部ホームページ(<http://wtak.jp/>)から、お申し込みください。
申込期限は、平成30年9月7日(金)です(定員に達した場合は、受付を終了します)。

※セミナー参加は無料です。

情報交換会に参加希望の方は、参加費(4千円)を当日受付でお支払いください。



<大阪市内での良好な成長例>



会場へのアクセス

